

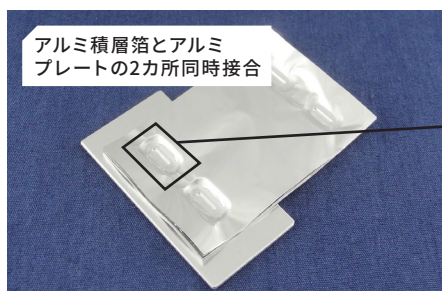
Application

<https://ultex.co.jp>Bonding ボンディング

Patented

リチウムイオン電池 電極の接合

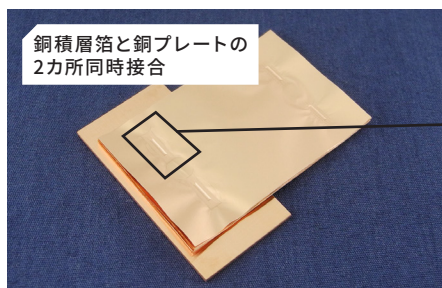
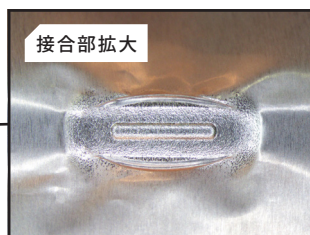
更に進化したMSBでLIB積層箔100枚以上の複数ヶ所 同時接合

アルミ積層箔とアルミ
プレートの2カ所同時接合

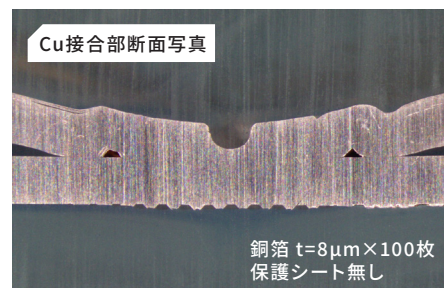
接合部拡大



Al接合部断面写真

アルミ箔 t=15 μ m×100枚
保護シート無し銅積層箔と銅プレートの
2カ所同時接合

接合部拡大



Cu接合部断面写真

銅箔 t=8 μ m×100枚
保護シート無し

クリップ合金接合/Clip-Ingot Bonding

CIBツールの先端形状は丸みを帯びておりエネルギーを集中できます。これまでのメッシュツールによる接合とは異なり、傷が付かないホッチキスで綴じた様な、コンタミが発生しないソフトタッチの綺麗な接合方法です。

進化したMSB/Multi-Step Bonding ツール

MSBツールでは丸みを帯びた先端形状が多段に重なりエネルギーがより先端部に集中し、スムーズに接合することができます。その結果接合時間を短縮でき、積層箔へのダメージをより軽減し、接合音が小さくなり、接合強度が更に増します。

Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0059A4-2026070201